

取付適用規格
Application Specification

1. 適用範囲

本取付適用規格は、MICRO POKE IN 1Pの取付け条件およびワイヤ挿入条件について規定する。

1. Applicable scope

This Application Specification provides for the requirements of mounting and wire installation to MICRO POKE IN 1P Connectors.

2. 適用コネクタ

名称：MICRO POKE IN 1P

製品型番：2134611-1

2. Applicable connectors

NAME：MICRO POKE IN 1P

PRODUCT MODEL NO：2134611-1

3. 適用電線

MICRO POKE IN 1Pに適用するワイヤをFig. 1に示す。

3. Applicable wires

The Applicable wires to MICRO POKE IN 1P is shown in Fig. 1

電線サイズ Wire Range AWG#. No	素線数／素線径 (本/mm) Number of Conductors/ Diameter of a conductor (Number of Conductors /mm)	絶縁被覆仕上げ径 (mm) Insulation Diameter (mm)	ワイヤ芯線 Wire core
24	1/0.511	φ1.06～φ1.35	錫めっき軟銅線 tin plating annealed copper wire
26	1/0.404		

Fig. 1

- 4. ワイヤストリップ長さ及びワイヤ挿入に関する注意事項
- 4. Wire strip length and wire insertion instruction

4.1 ワイヤストリップ長さ

ワイヤストリップ長さについてFig. 2に示す。

4.1 Wire strip length

The wire strip length is shown in Fig. 2

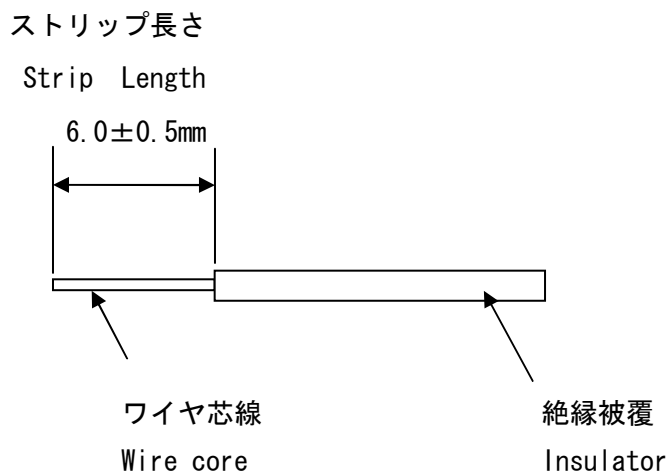


Fig. 2

4.2 ワイヤ挿入に関する注意事項

- 4.2.1 被覆剥ぎの際には、芯線をまっすぐに抑え、傷や欠落を生じないようにすること。
- 4.2.2 ワイヤ挿入時、ワイヤ絶縁被覆がMicro poke inのハウジング内部に突き当たるまで挿入すること。(Fig. 3参照)
- 4.2.3 ワイヤの挿入後、ワイヤ芯線がLINE 1を越えているか確認すること。(Fig. 4参照)
- 4.2.4 ワイヤ挿入後、ワイヤとコンタクトの接点部に負荷がかかる挙動なきこと。
- 4.2.5 MICRO POKE IN 1Pからワイヤを引抜いた場合、ワイヤ及びMICRO POKE IN 1Pの再使用不可。(リペア不可)

4.2 Wire insertion instruction

- 4.2.1 Wire-end must be neatly stripped without damages, breakage and nick of wire strand.
- 4.2.2 Insert it until the wire insulator part bumps in the housing of MICRO POKE IN 1P when you insert the wire. (ref Fig.3)
- 4.2.3 After insert the wire, confirm that wire core is over Line1. (ref Fig.4)
- 4.2.4 After insert the wire, there is no load between wire and contact's contact point.
- 4.2.5 When the wire is pulled out from MICRO POKE IN 1P, do not reuse the wire and MICRO POKE IN 1P. (Must not repair.)

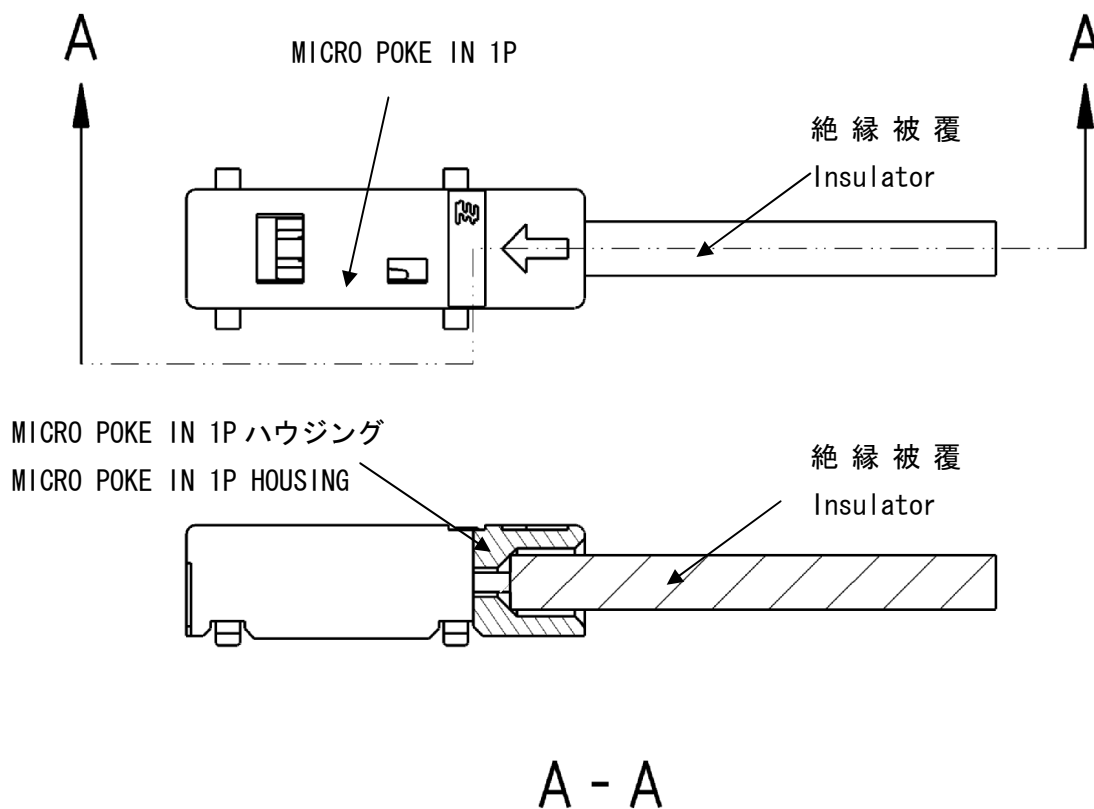


Fig. 3

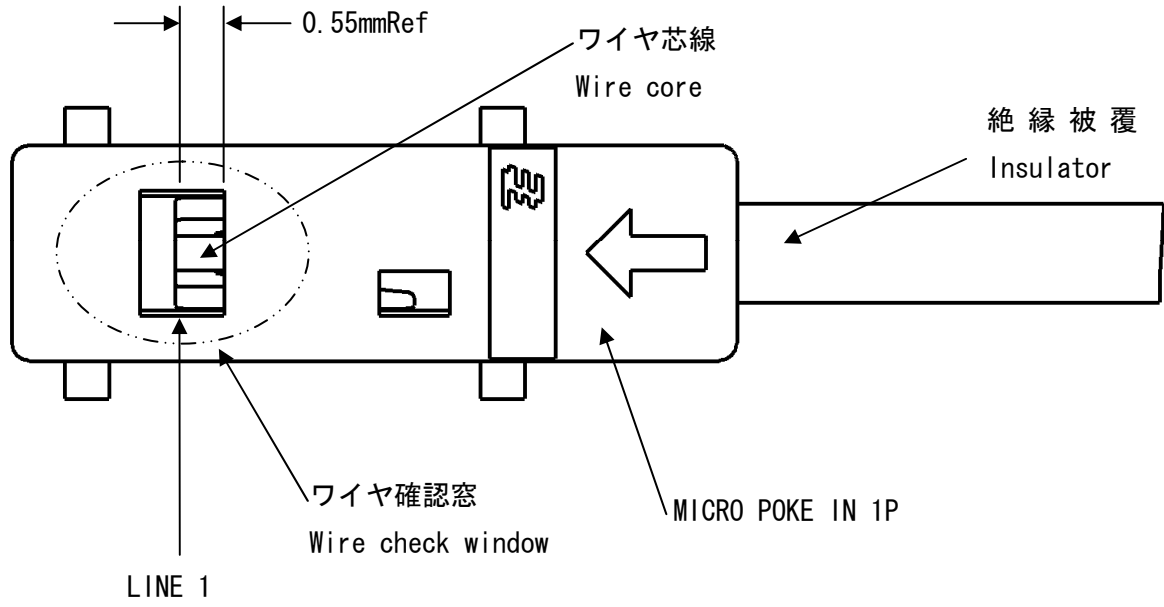


Fig. 4

5. PCBへのコネクタの実装について

5. Mounting the connector on the PCB

5.1 PCBパッドレイアウト

PCBレイアウトは顧客図面に書かれている寸法を使用しデザインすることを推奨する。

PCB参考レイアウトを図5に示す。

5.1 PCB PAD Layout

The PCB PAD Layout is recommended to design using the dimensions provided on the customer drawing for the specific connector.

Referential PCB PAD Layout is shown in Fig 5.

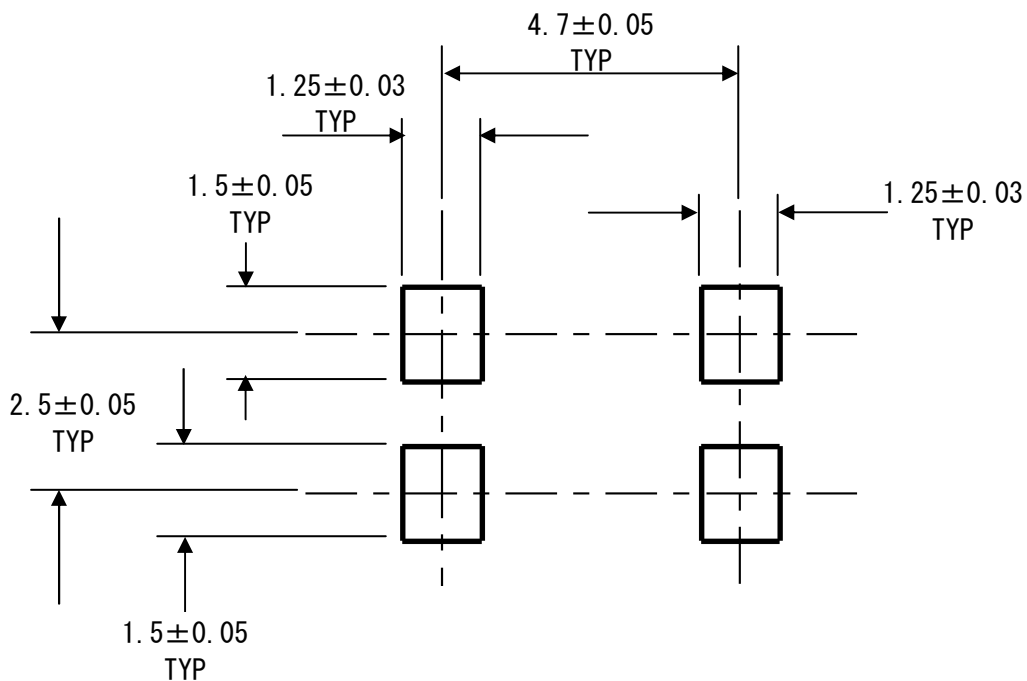


Fig. 5

5.2 メタルマスクパッド開口及びメタルマスク厚

メタルマスクパッド開口レイアウトは顧客図面に書かれている寸法を使用しデザインすることを推奨する。

メタルマスクパッド開口参考レイアウトを図6に示す。

メタルマスク厚は0.15mmを推奨する。

5.2 Metal Mask Layout and Thickness

The Metal Mask Layout is recommended to design using the dimensions provided on the customer drawing for the specific connector.

Referential Metal Mask Layout is shown in Fig. 6.

Referential Metal Mask thickness is 0.15mm.

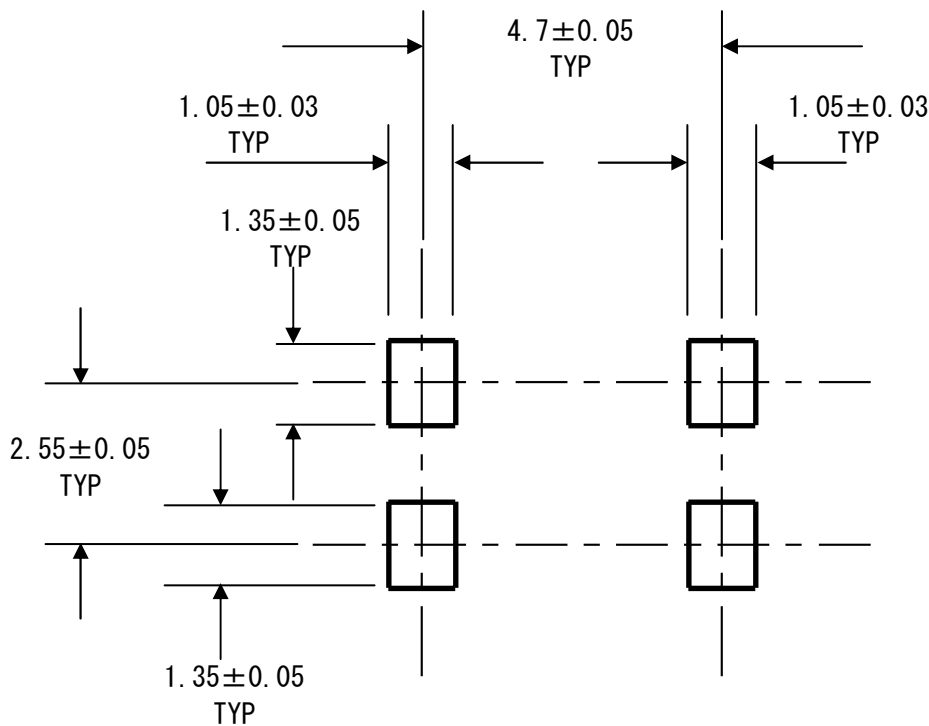


Fig. 6

5.3 リフロー温度プロファイル

リフロー温度プロファイル(参考)を図7に示す。(IPC/JEDEC J-STD-020Cに基づく)

5.3 Reflow temperature profile

Referential reflow temperature profile is shown Fig.7. (based on IPC/JEDEC J-STD-020C)

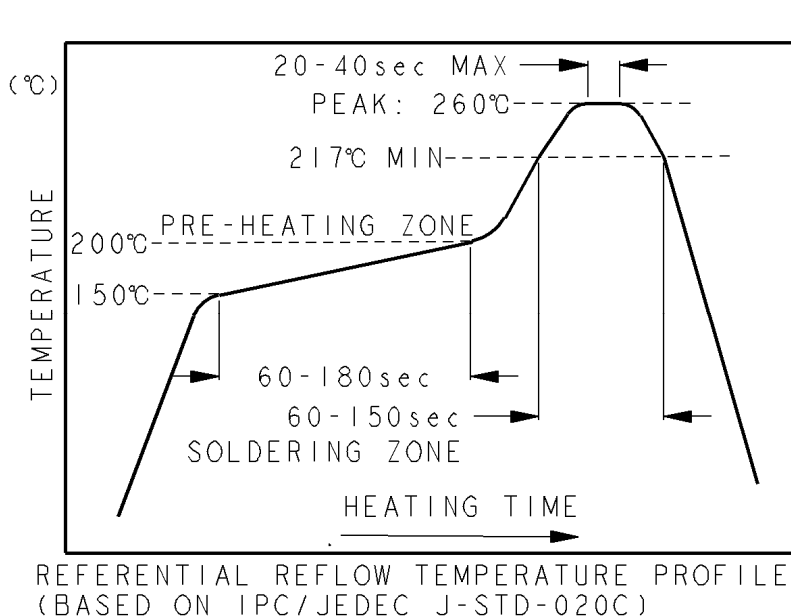


Fig.7

5.4 吸着エリア

吸着エリア参考位置を図8に示す。

5.4 Vacuum area

Referential Vacuum area is shown Fig.8.

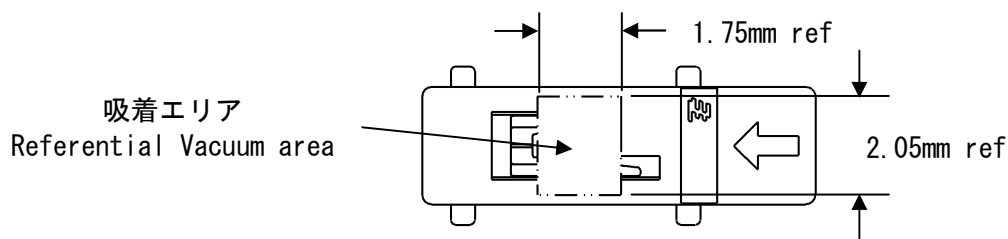


Fig.8

6. 改訂記録 Revision Record

改訂記号 (Rev)	説明 (Description)	日付 (Date)
A	作成 (Released)	13・APR・10
B	改訂 (Revised)	05・NOV・10
C	改訂 (Revised)	11・NOV・10
D	改訂 (Revised)	11・MAY・11